

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，故並無載列對閣下可能屬重要的所有資料。閣下於決定[編纂][編纂]前，務請閱覽整份文件（包括財務報表及隨附附註）。任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下於決定[編纂][編纂]前，務請細閱該節全文。

概覽

我們是全球知名的高端印製電路板(PCB)製造商，亦是全球領先的車載PCB供應商之一。公司成立於2015年，PCB業務淵源可追溯至1988年。我們致力研發、生產及商業化一系列高可靠性、高複雜度PCB產品，包括雙面板、多層板及高密度互連(HDI)板，該等產品乃幾乎所有電子系統的物理互連基礎。我們的主要生產基地位於中國黃石及昆山，並在泰國設有戰略性海外製造基地，服務多個先進應用領域的全球領先客戶：汽車電子構成我們業務的商業及技術基礎，而數據存儲、通信及AI服務器應用則為日益重要的增長引擎。我們相信，車規級質量管控、製程技術的不斷進步及全球製造能力的結合，使我們得以由領先的車載PCB供應商演進為智能硬件時代的全球高端PCB製造商。

下圖展示我們的業務亮點。

市場地位⁽¹⁾ - 車載PCB：2025年位列全球第8，2026年上半年位列全球第6 - 汽車HDI板：全球第1⁽²⁾ - 內存模塊PCB：全球第3⁽²⁾ - AI數據存儲PCB：全球第3⁽²⁾	藍籌全球客戶群⁽³⁾ - 全球前十大汽車一級供應商中的四家 - 全球前四大DRAM製造商中的三家 - 全球前五大顯示面板製造商全體 廣泛覆蓋AI生態系統內多家龍頭客戶，包括領先GPU製造商、雲端服務提供商及交換機供應商	收入規模及多元化應用組合 2025年收入人民幣48億元，2023年至2025年複合年增長率為14.0% 2026年上半年收入人民幣29億元，同比增長33.3% 2026年上半年，汽車電子、數據存儲以及通信及AI服務器分別佔總收入的51.4%、15.8%及10.0%
全球生產佈局 - 於中國黃石、昆山及泰國設有三個生產基地 2026年上半年，71.8%的收入來自交付至中國保稅區及海外市場的產品，包括亞洲其他地區、歐洲、美洲及非洲	先進製造能力 具備 - 六階HDI 50層非對稱疊構 - 最高12層任意層互連HDI產品的商業化生產能力	可持續製造 2025年可再生能源消耗量為141,000兆瓦時，佔總能耗23.7%，廢物回收率93.6% - 黃石生產基地獲UL 2799鉑金級廢棄物零填埋認證及國際可持續水管理聯盟認證

(1) 行業排名根據弗若斯特沙利文報告，按銷售收入計算。
(2) 汽車HDI板、內存模塊PCB及AI數據存儲PCB排名同時適用於2025年及2026年上半年。
(3) 客戶排名依據弗若斯特沙利文報告並基於2025年相關數據。

概 要

我們的產品

我們的主要產品為剛性板，為電子元件提供機械支撐，並為電氣連接提供導电路徑。下圖列示我們的主要PCB產品及其應用領域。



- **雙面板**。我們的雙面板包括兩層導電銅層，分別位於絕緣基材兩側，通常通過金屬化通孔實現連接。其適用於電路複雜度中等的產品，並且主要用於汽車電子及顯示應用。
- **多層板**。我們的多層板包括多個導電層，以絕緣材料分隔並壓合成單一電路板，提供額外的佈線空間，並支持更複雜的電路佈局、電源分配及信號傳輸。我們進一步將該等產品分為4至6層PCB、8至14層PCB及16層及以上PCB，可服務範圍覆蓋車輛控制系統、存儲模塊、通訊設備及AI算力板。
- **HDI板**。我們的HDI板使用微孔、盲孔及埋孔以及順序增層結構來實現更密集的互連、更精細的佈線及更高的元件集成度。該等產品支持我們主要應用領域的緊湊設計和高速信號傳輸。彼等可應用於自動駕駛及智能座艙域控制器、內存模塊、GPU加速卡載板及AI算力板等高端產品。

下表載列所示期間按產品類別劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比
(人民幣千元，百分比除外)										
(未經審核)										
PCB產品銷售										
雙面板	265,049	7.2	263,068	6.4	227,430	4.8	120,464	5.5	109,314	3.8
多層板	2,415,320	66.1	2,330,272	56.5	2,428,281	51.1	1,150,243	52.7	1,324,441	45.4
4至6層	1,560,244	42.7	1,387,265	33.6	1,436,372	30.3	729,097	33.4	718,857	24.6
8至14層	855,007	23.4	940,024	22.8	980,077	20.6	419,595	19.2	600,564	20.6
16層及以上	69	0.0	2,983	0.1	11,832	0.2	1,551	0.1	5,020	0.2
HDI板	854,592	23.4	1,352,027	32.8	1,783,330	37.5	782,078	35.8	1,274,791	43.8
小計	3,534,961	96.7	3,945,367	95.7	4,439,041	93.4	2,052,785	94.0	2,708,546	93.0
其他 ⁽¹⁾	121,291	3.3	178,250	4.3	313,299	6.6	131,992	6.0	203,498	7.0
總計	3,656,252	100.0	4,123,617	100.0	4,752,340	100.0	2,184,777	100.0	2,912,044	100.0

概 要

(1) 主要包括廢料銷售。

汽車電子是我們的業務基石，亦為我們最大的應用板塊，分別佔2025年總收入的55.4%及截至2026年6月30日止六個月總收入的51.4%。我們專注於高端HDI板，可服務於三電系統以及自動駕駛及智能座艙域控制器。我們的全系列車載PCB產品組合亦可支持雷達及激光雷達、功率轉換及制動系統以及車窗及座椅控制。該等應用要求高可靠性及質量可追溯性，有賴於我們成熟的製造及量產能力。

數據存儲為另一重要增長領域，其對總收入的貢獻由2023年的7.0%上升至截至2026年6月30日止六個月的15.8%。我們的多層板及HDI板可用於內存模塊、固態硬盤及硬盤驅動器。視乎產品要求，該等PCB整合高速接口、細間距金手指結構、低損耗材料及精確的尺寸與阻抗控制，以滿足嚴苛的數據傳輸及存儲需求。

通信及AI服務器為日益重要的增長領域，其對總收入的貢獻由2023年的4.3%提升至截至2026年6月30日止六個月的10.0%。我們的產品可用於服務器、路由器、交換機、無線通信設備以及AI算力板。我們已具備六階HDI及50層非對稱疊構產品的商業化生產能力，並開發M7至M9級高速覆銅板的製程參數。我們正在開發八階HDI、60層及78層超高層數技術、M9級及以上材料，以及用於1.6T光模塊及共封裝光學的PCB。

顯示及消費電子進一步拓寬我們的產品組合，於截至2026年6月30日止六個月分別佔我們總收入的8.9%及5.9%。我們的顯示PCB包括可用於高分辨率顯示驅動板及車載顯示的產品，其工藝控制支持超大排版尺寸穩定性、層間對位及板面平整度。我們的消費電子產品組合主要包括可用於AI個人計算機、智能手錶及其他穿戴設備以及增強現實及虛擬現實頭戴式裝置的HDI板及精選多層產品。依託我們的精密製造及高密度互連能力，該等產品可支持緊湊輕薄設計、密集線路及高元件集成度。

下表載列所示期間按應用領域劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比	金額	佔總額百分比
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審核)			
PCB產品銷售	3,534,961	96.7	3,945,367	95.7	4,439,041	93.4	2,052,785	94.0	2,708,546	93.0
汽車電子	2,517,922	68.8	2,707,099	65.7	2,628,142	55.4	1,299,263	59.6	1,495,027	51.4
數據存儲	256,722	7.0	316,040	7.7	548,092	11.5	197,320	9.0	460,747	15.8
通信及AI服務器	156,223	4.3	283,889	6.8	440,895	9.3	177,281	8.1	291,213	10.0
顯示	430,615	11.8	431,204	10.5	519,447	10.9	242,077	11.1	260,294	8.9
消費電子	163,288	4.5	187,615	4.5	266,933	5.6	125,077	5.7	172,214	5.9
其他 ⁽¹⁾	10,191	0.3	19,520	0.5	35,532	0.7	11,767	0.5	29,051	1.0
其他 ⁽²⁾	121,291	3.3	178,250	4.3	313,299	6.6	131,992	6.0	203,498	7.0
總計	3,656,252	100.0	4,123,617	100.0	4,752,340	100.0	2,184,777	100.0	2,912,044	100.0

(1) 其他PCB應用主要包括具身智能、工業控制、醫療及綠色能源領域的應用。

(2) 主要包括廢料銷售。

概 要

競爭優勢

我們堅信以下競爭優勢有助於我們取得成功：(1)以汽車電子為根基，把握AI運算及高速數據基礎設施增長機遇的成熟全球化PCB平台；(2)先進技術平台與客戶協同創新模式，將材料與製造製程專長轉化為高性能PCB；(3)全球藍籌客戶基礎疊加長期合作關係，支撐高值應用領域業績增長；(4)於中國及泰國的整合式製造平台服務全球客戶，兼具生產規模、質量管理與地理佈局彈性；及(5)經驗豐富的管理與技術團隊貫通客戶洞察、工程專長及製造執行，助力長期增長。

增長戰略

我們擬採取以下戰略以進一步拓展業務：(1)擴充並升級全球產能，同時推動自動化、數字化整合與可持續製造；(2)加快通信及AI服務器、數據存儲及汽車電子領域的產品組合升級，以滿足對更高規格PCB的需求；(3)加大對先進材料、互連結構及精密製程的研發投入，以支持更高層數、更高密度和更高速度的產品及其向穩定量產的過渡；及(4)在全球範圍內招聘、發展及留住技術、運營及管理人員，以支持先進技術、海外產能擴張及跨境運營。

我們的技術

我們的技術平台涵蓋三個主要領域：材料技術、製造工藝技術及產品開發技術。我們的能力覆蓋PCB產品生命週期的主要階段，從材料選擇及工藝開發到試產、轉量產及後續工藝優化。我們協同材料、疊構架構、製造參數及質量控制標準，以滿足客戶設計及性能要求。

- **材料技術。**我們的能力包括超低稜線銅面處理以及高頻高速材料加工。我們的銅面處理工藝可將算術平均表面粗糙度由約2,900納米降低至約100納米，從而在維持層間結合及耐熱性的同時降低高頻導體損耗。我們亦應用多段式合控制來支持多層混壓結構中不同材料之間的可靠結合，並滿足更高速產品的信號完整性要求。
- **製造工藝技術。**我們的能力包括精密背鑽及殘銅控制、埋孔及填孔工藝及共面次非對稱銅加工。該等工藝支持高速信號傳輸、密集佈線、元件裝配及超大排版PCB的穩定生產。尤其是，我們的共面次非對稱銅加工使大電流或高功率區域與精細線路數字信號區域能夠共存於同一層。
- **產品開發技術。**我們的能力涵蓋高層數HDI及微孔加工、輻射天線尺寸控制及凹槽及盲槽加工，可滿足高密度互連、天線精度及減小裝配厚度的需求。我們已具備最高20層任意層互連HDI的樣品製作能力且正在開發八階HDI、改進型半加成法精細線路加工及極微孔技術。我們亦已具備六階HDI及50層非對稱疊構產品的商業化生產能力，並持續開發60層及78層超高層數技術。

概 要

銷售及營銷

我們為中國及海外客戶提供服務，產品交付至亞洲其他地區、歐洲、美洲及非洲。根據交付目的地，於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年6月30日止六個月，海外市場及中國保稅區的銷售分別佔我們總收入的79.0%、79.2%、75.6%、78.7%及71.8%。

我們的產品一般按客戶規格定製，且我們主要直接向電子產品製造商銷售。我們的主要客戶開發方式包括由銷售及技術人員直接接洽，以及我們的海外辦事處及銷售代理商提供支持。我們力求盡早參與客戶的產品開發週期，新客戶項目一般須經過商業及技術討論、供應商或工廠資質認證、樣品生產、可靠性測試及客戶驗證，方可獲量產批准。

我們委聘少量銷售代理商，就若干直銷客戶提供市場開發、商務溝通及客戶服務協調支持。儘管該等客戶於往績記錄期間貢獻較大部分收入，惟相關收入乃由直接向客戶銷售產生，而非向代理商銷售。銷售代理商通常並不購買或轉售我們的產品或取得產品的所有權，且我們仍為負責供應產品的合約方。

生產

截至2026年6月30日，我們運營三個生產基地：位於中國湖北省的黃石生產基地、位於中國江蘇省的昆山生產基地以及位於巴真府的泰國生產基地。我們主要採用按單生產、銷售驅動的生產模式。我們參考已確認採購訂單、客戶預測、交付要求、材料供應情況、工藝要求以及各生產基地的能力及負荷編製生產計劃。訂單根據產品規格、所需工藝及交付計劃在各生產基地及生產線之間分配。

於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年6月30日止六個月，我們的整體產能利用率分別為90.7%、93.6%、86.3%、83.2%及94.8%。利用率因客戶下單模式、產品組合、認證進度及生產爬坡而異。我們的泰國生產基地於2024年第四季度開始商業化生產且於往績記錄期間仍處於爬坡階段，涉及客戶及工廠資質認證、產品驗證、工藝調整及良率穩定。

我們內部開展產品工程、工藝設計、生產管理及質量控制的核心環節。當特定工藝的內部產能暫時受限，或生產排程需要額外靈活性時，我們可能委聘獨立第三方加工商進行有限、短期及單一工序的加工，例如若干鑽孔、電鍍或電測工序。我們通常不會將整筆PCB生產訂單外包。

客戶

我們的客戶主要於汽車電子、數據存儲、通信及AI服務器、顯示及消費電子領域以及其他應用領域營運。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年6月30日止六個月，我們五大客戶於各期間的收入分別為人民幣1,823.7百萬元、人民幣1,775.1百萬元、人民幣1,814.1百萬元及人民幣1,009.5百萬元，佔有關期間總收入的49.9%、43.0%、38.2%及34.7%。於同期，我們最大單一客戶的收入分別為人民幣636.9百萬元、人民幣567.6百萬元、人民幣543.9百萬元及人民幣281.9百萬元，佔有關期間總收入的17.4%、13.8%、11.4%及9.7%。

概 要

供應商

我們的主要原材料主要從中國內地採購，包括覆銅板、半固化片、金鹽、銅箔、銅球或銅粉、乾膜、油墨、化學溶液及其他輔助材料。我們實行集中採購框架，由各生產基地的採購人員負責訂單執行及當地協調。對於主要材料，除非客戶指定特定來源，我們通常維持至少兩名合資格供應商。

於2023年、2024年、2025年以及截至2026年6月30日止六個月，我們向五大供應商的採購於各期間分別為人民幣737.1百萬元、人民幣919.3百萬元、人民幣1,220.7百萬元及人民幣904.0百萬元，佔有關期間總採購額的41.5%、40.1%、42.2%及45.3%。於同期，我們向最大單一供應商的採購分別為人民幣188.9百萬元、人民幣272.7百萬元、人民幣386.7百萬元及人民幣282.6百萬元，佔有關期間總採購額的10.6%、11.9%、13.4%及14.2%。

市場機遇及競爭

根據弗若斯特沙利文報告，全球PCB市場由2021年的769億美元增加至2025年的858億美元，複合年增長率為2.8%，且預期將按9.1%的複合年增長率由2026年的1,020億美元增加至2030年的1,446億美元。預期市場增長加速反映行業的結構增長且預期將由高價值應用領域日益增長的需求支持，包括AI伺服器、數據中心、汽車電子、數據存儲及高速通信，其正提高每台設備的PCB含量並推動產品組合向技術更加複雜、價值更高的PCB產品升級。因此，需求日益轉向高價值產品，HDI板及多層板於2026年至2030年預期將分別按10.8%及9.8%複合年增長率增加。

我們的主要應用市場由汽車電動化及智能化、AI計算、雲計算以及數據中心擴展支持。全球車載PCB市場由2021年的83億美元增加至2025年的98億美元，且預期將於2030年前達134億美元。於該市場中，汽車HDI板預期將於2026年至2030年按14.3%的複合年增長率增長，高於車載PCB市場的平均水平6.1%。全球數據存儲PCB市場由2021年的47億美元增加至2025年的61億美元，且預期將按13.7%的複合年增長率由2026年的94億美元增加至2030年的157億美元。全球通信與AI伺服器PCB市場由2021年的95億美元增加至2025年的209億美元，成為該期間增長最快的PCB應用細分領域，且預期將按13.9%的複合年增長率由2026年的281億美元增加至2030年的472億美元。

該等應用需要更加緊密的互連、更加快速的傳輸、更強的可靠性以及經改善的熱管理，以支持對於技術層面更加複雜的PCB的需求。客戶日益重視供應鏈韌性及區域化交付亦支持對東南亞多元化生產能力的需求。我們相信，該等趨勢為兼具先進工藝能力、嚴謹質量體系、可擴展產能、穩固客戶關係及海外製造能力的製造商創造機遇。

全球PCB市場較為分散且競爭激烈。根據弗若斯特沙利文報告，於2025年，10大市場參與者佔全球PCB銷售收入的37.7%，競爭日益專注於高端產品與綜合能力，而非僅產能擴張。我們於技術、產品品質、製造能力、定價、良率、交付表現及客戶服務方面進行競爭。高端PCB市場存在與技術與工藝專業知識、客戶資質以及於大規模生產中保持一致品質、可追溯性及交付能力有關的重大進入壁壘。於車載PCB市場，我們於2025年及2026年上半年分別位列全球第八及第六。於兩個期間，我

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

們於車載HDI板市場位列全球第一及於內存模塊PCB市場及AI數據存儲PCB市場均位列全球第三，以上各項均按銷售收入計。

風險及挑戰

我們的業務及[編纂]涉及若干風險，其載於本文件「風險因素」一節。我們面臨的部分主要風險因素包括：(1)PCB行業的激烈競爭及下游需求或我們的應用及產品組合的不利變化，其可導致訂單、銷售價格以及盈利能力減少；(2)依賴少數主要客戶，其訂單減少、延遲、重新分配或取消以及議價能力可對我們的業務及經營業績產生不利影響；(3)原材料短缺、品質問題或價格上漲、採購集中於主要供應商以及難以及時或完全將增加的成本轉予客戶；(4)繼於截至2026年6月30日止六個月錄得淨虧損後，毛利率及盈利能力持續下降以及進一步虧損的風險；及(5)客戶、工廠、材料及產品認證流程漫長且不確定，以及未能開發、驗證並商業化新款或改款PCB產品及製造技術。由於不同[編纂]於釐定風險重要性時可能存在不同詮釋與標準，閣下應於決定[編纂]H股前仔細閱讀「風險因素」整節。

綜合損益表

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	金額	佔收入百分比	金額	佔收入百分比	金額	佔收入百分比	金額	佔收入百分比	金額	佔收入百分比
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審核)			
收入	3,656,252	100.0	4,123,617	100.0	4,752,340	100.0	2,184,777	100.0	2,912,044	100.0
銷售成本	(2,795,430)	(76.5)	(3,201,579)	(77.6)	(3,800,781)	(80.0)	(1,703,785)	(78.0)	(2,469,192)	(84.8)
毛利	860,822	23.5	922,038	22.4	951,559	20.0	480,992	22.0	442,852	15.2
其他收入及收益	59,595	1.6	91,264	2.2	89,793	1.9	63,984	2.9	20,895	0.7
銷售及營銷開支	(132,064)	(3.6)	(133,085)	(3.2)	(106,236)	(2.2)	(53,045)	(2.4)	(71,566)	(2.5)
行政開支	(211,262)	(5.8)	(288,775)	(7.0)	(305,731)	(6.4)	(145,683)	(6.7)	(149,627)	(5.1)
研發開支	(122,070)	(3.3)	(135,028)	(3.3)	(162,531)	(3.4)	(70,742)	(3.2)	(108,229)	(3.7)
金融資產減值虧損撥回／(減值虧損)										
淨額	7,101	0.2	3,371	0.1	(1,503)	(0.0)	(2,039)	(0.1)	1,634	0.1
其他開支	(52,559)	(1.4)	(27,725)	(0.7)	(73,895)	(1.6)	(37,926)	(1.7)	(235,813)	(8.1)
財務成本	(92,190)	(2.5)	(103,117)	(2.5)	(124,399)	(2.6)	(57,767)	(2.6)	(78,172)	(2.7)
稅前利潤／(虧損)	317,373	8.7	328,943	8.0	267,057	5.6	177,774	8.1	(178,026)	(6.1)
所得稅開支	(51,218)	(1.4)	(52,726)	(1.3)	(35,707)	(0.8)	(18,975)	(0.9)	(13,180)	(0.5)
年／期內利潤／(虧損)	266,155	7.3	276,217	6.7	231,350	4.9	158,799	7.3	(191,206)	(6.6)

綜合財務狀況表概要

	截至12月31日			截至2026年6月
	2023年	2024年	2025年	30日
	(人民幣千元)			
非流動資產總額	2,661,920	4,197,324	4,765,751	6,023,339
流動資產總額	2,244,462	2,599,460	3,675,370	4,329,816
流動負債總額	2,253,351	3,953,809	2,954,822	4,297,887
流動(負債)／資產淨額	(8,889)	(1,354,349)	720,548	31,929
資產總額減流動負債	2,653,031	2,842,975	5,486,299	6,055,268
非流動負債總額	1,119,735	996,412	2,583,775	3,530,035
資產淨額	1,533,296	1,846,563	2,902,524	2,525,233

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

選定現金流量表資料

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
			(人民幣千元)	(未經審核)	
經營活動所得現金流量淨額	818,494	605,800	412,729	209,134	65,855
投資活動所用現金流量淨額	(672,337)	(1,284,900)	(1,511,358)	(651,589)	(1,347,163)
融資活動所得現金流量淨額	92,991	579,600	1,566,056	737,772	1,396,153
現金及現金等價物					
增加／(減少)淨額	239,148	(99,500)	467,427	295,317	114,845
年／期初現金及現金等價物	315,900	585,005	541,087	541,087	1,014,752
匯率變動影響淨額	29,957	55,582	6,238	20,475	(36,185)
年／期末現金及現金等價物	585,005	541,087	1,014,752	856,879	1,093,412

主要財務比率

	截至12月31日／截至12月31日止年度			截至2026年 6月30日／ 截至2026年 6月30日止 六個月
	2023年	2024年	2025年	
毛利率(%) ⁽¹⁾	23.5	22.4	20.0	15.2
淨利潤／(虧損)率(%) ⁽²⁾	7.3	6.7	4.9	(6.6)
股本回報率(%) ⁽³⁾	19.1	16.3	9.7	(14.1)
流動比率 ⁽⁴⁾	1.0	0.7	1.2	1.0
負債資產比率(%) ⁽⁵⁾	68.7	72.8	65.6	75.6

(1) 毛利率等於毛利除以收入。

(2) 淨利潤／(虧損)率等於年／期內利潤／(虧損)除以收入。

(3) 股本回報率等於年／期內利潤／(虧損)除以期初及期末權益總額的平均值。截至2026年6月30日止六個月的股本回報率按六個月回報率乘以2進行年化處理。

(4) 流動比率等於流動資產總額除以流動負債總額。

(5) 負債資產比率等於負債總額除以資產總額。

[編纂]

截至2026年6月30日止六個月，我們預付H股[編纂]人民幣[編纂]元。我們的[編纂]主要包括：(1)與[編纂]有關的開支，例如[編纂]費及[編纂]；(2)非[編纂]相關開支，包括向法律顧問及申報會計師就[編纂]及[編纂]提供服務而支付的專業費用；及(3)其他費用及開支。假設酌情獎勵費獲悉數支付，[編纂]的估計[編纂]總額(按指示性[編纂]中位數計算，並假設[編纂]未獲行使)約為[編纂]港元，佔[編纂]總額約[編纂]%。在該等估計[編纂]總額中，我們預期支付與[編纂]有關的開支[編纂]港元、法律顧問及申報會計師的專業費用[編纂]港元以及其他費用及開支[編纂]港元。我們的[編纂]中估計[編纂]港元(佔[編纂]總額約[編纂]%)已或預期將於損益表中列支，而餘下[編纂]港元預期於[編纂]後直接確認為權益扣減。

概 要

我們於上海證券交易所上市

自2025年10月起，我們的A股在上海證券交易所上市（「A股上市」）。我們的董事確認，自我們的A股上市起及直至最後實際可行日期，我們並無重大違反上海證券交易所適用規則及其他適用的中國證券法律法規的情況。

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，DEH有權通過其直接持有的376,277,619股A股行使本公司約86.10%的表決權。DEH由Wintek Mauritius全資擁有，Wintek Mauritius由定穎電子全資擁有，定穎電子則由定穎投控全資擁有。定穎投控為一家於台灣證券交易所上市的公司（股份代碼：3715），且截至最後實際可行日期，定穎投控的股東均無持有其30.00%或以上的股權。

緊隨[編纂]完成後，DEH、Wintek Mauritius、定穎電子及定穎投控將有權行使本公司約[編纂]%的表決權（假設[編纂]未獲行使，概無根據2026年購股權計劃發行新股份，且於最後實際可行日期至[編纂]期間，本公司已發行股本概無發生其他變動）。因此，DEH、Wintek Mauritius、定穎電子及定穎投控將於[編纂]後構成一組我們的控股股東。

[編纂]

概 要

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述指示性[編纂]的中位數)及[編纂]未獲行使，我們估計[編纂][編纂]淨額(經扣除與[編纂]有關的[編纂]以及其他估計費用及開支後)將約為[編纂]港元。我們擬將[編纂]的[編纂]淨額用於以下用途：(1)約[編纂]%或[編纂]港元用於產能擴張及智能升級，以把握AI計算基礎設施、智能汽車及先進數據存儲應用領域對先進PCB日益增長的需求；(2)約[編纂]%或[編纂]港元用於研發項目，以增強我們的創新能力及技術儲備，並支持更高規格產品的商業化；及(3)約[編纂]%或[編纂]港元用於營運資金及其他一般企業用途。有關[編纂]的未來計劃及[編纂]用途的更多資料，請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

股息

於2023年、2024年及2025年，我們並無宣派任何股息。於2026年5月，我們的股東週年大會批准末期股息人民幣69.9百萬元，並於2026年7月悉數支付。日後利潤分配可採取現金股息、股票股息或兩者結合的形式，而現金股息所佔比例將參考我們的發展階段及資本開支需求釐定。我們並無固定的派息比率。任何建議股息分派須經董事會審閱(包括審計委員會審閱)，並經股東於股東會上批准。董事會在考慮是否建議任何日後股息分派及其金額時，將計及(其中包括)我們的經營業績、財務狀況、營運及資本需求、股東利益，以及董事會可能認為相關的其他因素。

申請於聯交所[編纂]

本公司已向聯交所申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何H股)[編纂]及[編纂]，基準為(其中包括)本公司符合上市規則第8.05(3)條項下的市值／收益測試，並參考(1)本集團截至2025年12月31日止財政年度的收益約為人民幣4,752.3百萬元(相當於約5,504.8百萬港元)，超過500百萬港元；及(2)本公司於[編纂]時的預期市值約為[編纂]港元(按指示性[編纂]的下限計算)，超過40億港元。

近期發展

董事確認，於往績記錄期間後及直至本文件日期，(1)本集團經營所在的市場狀況及監管環境概無發生對我們的財務或經營狀況產生重大不利影響的重大不利變動；(2)我們的業務、收入結構、盈利能力、成本結構、財務狀況及前景並無重大不利變動；及(3)概無發生會對本文件附錄一所載會計師報告所示資料造成重大不利影響的事件。